

ePaste Ag添加 汎用鉛フリーソルダペースト

SN99CN P506 D4



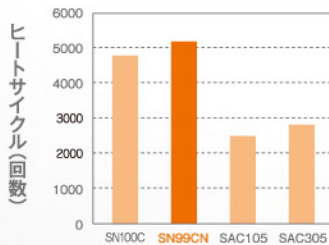
Ag添加とNi効果で、かつてない接合強度を実現

SN99CNは鉛フリーはんだ「SnCuNi」合金に微量のAgを添加することで、接合界面に安定した合金層を形成し、かつてない接合強度を実現した新合金です。

落下衝撃に強いいためポータブル機器などの基板接合に最適です。

Ag 1.1%	鉛 フリー	高強度	印刷用
耐ヒート サイクル性 良好	経時安定性 良好	チップ立ち 抑制	

耐ヒートサイクル特性 Ni添加により耐久性を向上



はんだ合金	サイクル数
SN100C	4822
SN99CN	5197
SAC105	2518
SAC305	2880

【試験条件】
基板温度125℃/30分、-40℃/30分、サイクル数は全体の63%がオープンになるまでの回数を示す(抵抗値変化により測定)

繰返し印刷性 粘度上昇が少なく、安定した印刷性を保持

印刷形状の外観写真

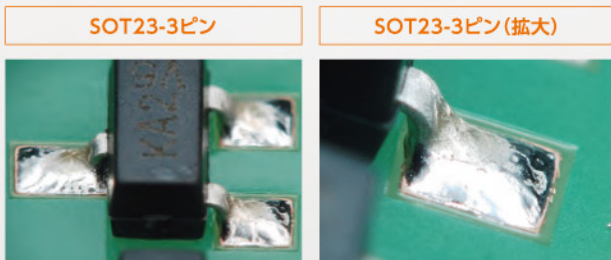


【試験条件】
はんだ充填量：350g
基板パターン：0.4mmピッチQFP
メタルマスク厚：120μm
印刷環境：25℃ 30~50%RH
印刷速度：30mm/sec.

【試験条件】
印刷試験を行い0時間、4時間、8時間毎に粘度を測定。4時間毎にはんだを補填し、8時間毎に容器を回収して冷蔵保存。この試験を7日間連続して実施した。

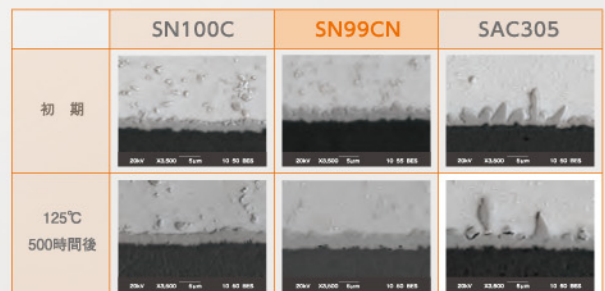
ぬれ上がり リード端面部のぬれ上がりが良好

はんだ付部の外観写真



【試験条件】
印刷厚：120μm / 昇温速度：1.5℃/sec. ピーク温度：240℃ / はんだ溶融時間：50sec.

接合界面の状態 平坦な合金層((Cu,Ni)₆Sn₅)を形成



※上記データ、写真は特定条件下によるものです。